

# (12) International Application Status Report

**Received at International Bureau:** 24 May 2017 (24.05.2017)

**Information valid as of:** 03 July 2017 (03.07.2017)

**Report generated on:** 20 March 2019 (20.03.2019)

**(10) Publication number:**

WO2017/208770

**(43) Publication date:**

07 December 2017 (07.12.2017)

**(26) Publication language:**

Japanese (JA)

**(21) Application Number:**

PCT/JP2017/017844

**(22) Filing Date:**

11 May 2017 (11.05.2017)

**(25) Filing language:**

Japanese (JA)

**(31) Priority number(s):**

2016-108540 (JP)

**(31) Priority date(s):**

31 May 2016 (31.05.2016)

**(31) Priority status:**

Priority document received (in compliance with PCT Rule 17.1)

**(51) International Patent Classification:**

**B32B 27/16** (2006.01); **B32B 27/26** (2006.01); **H01L 51/50** (2006.01); **H05B 33/02** (2006.01)

**(71) Applicant(s):**

LINTEC CORPORATION [JP/JP]; 23-23, Honcho, Itabashi-ku, Tokyo 1730001 (JP) *(for all designated states)*

**(72) Inventor(s):**

FURUYA Takumi; c/o LINTEC Corporation, 23-23, Honcho, Itabashi-ku, Tokyo 1730001 (JP)

NAGANAWA Satoshi; c/o LINTEC Corporation, 23-23, Honcho, Itabashi-ku, Tokyo 1730001 (JP)

IWAYA Wataru; c/o LINTEC Corporation, 23-23, Honcho, Itabashi-ku, Tokyo 1730001 (JP)

OHASHI Takehiro; c/o LINTEC Corporation, 23-23, Honcho, Itabashi-ku, Tokyo 1730001 (JP)

**(74) Agent(s):**

OHISHI Haruhito; Kotani Bldg. 1F, 5-3, Uchikanda 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1010047 (JP)

**(54) Title (EN):** LAMINATE, MEMBER FOR ELECTRONIC DEVICES, AND ELECTRONIC DEVICE

**(54) Title (FR):** STRATIFIÉ, ÉLÉMENT POUR DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE, ET DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE

**(54) Title (JA):** 積層体、電子デバイス用部材、及び電子デバイス

**(57) Abstract:**

**(EN):** The present invention provides: a laminate which comprises at least a base layer, a gas barrier layer and a layer formed of a cured product of an energy-curable resin, and which is characterized in that the gas barrier layer is laminated on one surface of the base layer directly or with another layer being interposed therebetween, and the layer formed of a cured product of an energy-curable resin is laminated on another surface of the base layer directly or with another layer being interposed therebetween, said another surface being on the reverse side of the gas barrier layer-side surface; a member for electronic devices, which is formed of this laminate; and an electronic device which comprises this member for electronic devices. Consequently, the present invention provides: a laminate which has excellent gas barrier properties and is suitable for use in a bonding step of an electronic device since the laminate is not susceptible to the occurrence of curling or thermal shrinkage even if subjected to a thermal history; a member for electronic devices, which is formed of this laminate; and an electronic device which comprises this member for electronic devices.

**(FR):** L'invention concerne un stratifié qui possède au moins une couche de matériau de base, une couche barrière au gaz, et une couche constituée d'un produit durci d'une résine durcissable sous l'effet d'une énergie. Ce stratifié est caractéristique en ce que ladite couche barrière au gaz est stratifiée directement ou avec une autre couche pour intermédiaire d'un côté de ladite couche de matériau de base, et ladite couche constituée d'un produit durci d'une résine durcissable sous l'effet d'une énergie, est stratifiée directement ou avec une autre couche pour intermédiaire sur le côté de ladite couche de matériau de base opposé à la couche barrière au gaz. Enfin, l'invention concerne également un élément pour dispositif électronique constitué de ce stratifié, et un dispositif électronique équipé de cet élément pour dispositif électronique. Plus précisément, l'invention fournit un stratifié qui est doté d'excellentes propriétés de barrière au gaz, et qui permet une adaptation à un processus de collage de manière adéquate sur un dispositif électronique, en raison des faibles risques de gondolage ou de contraction thermique, y compris en cas d'antécédents

thermiques. Enfin, l'invention fournit un élément pour dispositif électronique constitué de ce stratifié, et un dispositif électronique équipé de cet élément pour dispositif électronique.

(JA): 本発明は、少なくとも基材層と、ガスバリア層と、エネルギー硬化性樹脂の硬化物からなる層とを有する積層体であって、前記ガスバリア層が、前記基材層の一方の側に、直接又はその他の層を介して積層されてなり、前記エネルギー硬化性樹脂の硬化物からなる層が、前記基材層の、ガスバリア層とは逆の側に、直接又はその他の層を介して積層されてなることを特徴とする積層体、この積層体からなる電子デバイス用部材、及び、この電子デバイス用部材を備える電子デバイスです。本発明によれば、ガスバリア性に優れ、かつ、熱履歴を受けても、カールや熱収縮が起こり難いため、好適に電子デバイスへの貼り合わせ工程へ適用できる積層体、この積層体からなる電子デバイス用部材、及び、この電子デバイス用部材を備える電子デバイスが提供される。

#### **International search report:**

Received at International Bureau: 03 July 2017 (03.07.2017) [JP]

#### **International Report on Patentability (IPRP) Chapter II of the PCT:**

Not available

#### **(81) Designated States:**

AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

European Patent Office (EPO) : AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR

African Intellectual Property Organization (OAPI) : BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG

African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) : BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW

Eurasian Patent Organization (EAPO) : AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM